

# Tecnología Vasca

## El DIPC pone en marcha Colloquia

Donostia International Physics Center (DIPC) ha puesto en marcha los DIPC Colloquia, una iniciativa que programará charlas mensuales de la mano de ponentes excepcionales cubriendo todas las áreas de las ciencias.

## El Basque Digital Innovation Hub allanará el camino a la innovación

La nueva red impulsada por el Gobierno Vasco proporcionará a las pymes las tecnologías necesarias para afrontar la Industria 4.0

► Basque Digital Innovation Hub echará a andar próximamente con el fin de dotar a las empresas vascas de las capacidades tecnológicas necesarias para hacer frente a los desafíos que comporta la Industria 4.0. La nueva red digital de infraestructuras de I+D es la última de las apuestas del grupo de pilotaje de Fabricación Avanzada.

AINARA LOZANO. Bilbao

La estrategia vasca de especialización inteligente en Fabricación Avanzada ha dado un nuevo paso al frente con el próximo lanzamiento del Basque Digital Innovation Hub, una red que respaldará al tejido empresarial en su adaptación al nuevo paradigma industrial que plantea la denominada Industria 4.0. Según explica la responsable de Iniciativas Estratégicas de la SPRI y coordinadora del grupo de pilotaje de Fabricación Avanzada, Cristina Oyón, el objetivo es proporcionar a la industria, y en especial a las pymes, las capacidades tecnológicas necesarias para hacer frente a los desafíos que conlleva la fabricación avanzada. Una meta para la que han concebido esta red unida digitalmente de infraestructuras de I+D, plantas piloto y conocimientos

técnicos especializados en diferentes áreas de la fabricación avanzada a partir de las entidades que conforman la Red Vasca de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y es que las empresas adscritas al hub podrán recurrir a esta red digital para conocer y acceder de una mejor forma a las tecnologías existentes, así como para el desarrollo de proyectos de I+D, escalado de iniciativas industriales, tecnologías de vanguardia y recursos para la capacitación y la aceleración de *start ups*. Para la creación del Hub, el grupo de pilotaje de Fabricación Avanzada ha diseñado lo que han venido a llamar 'nodos', uno centrado en la

### La red se articula en torno a dos nodos tecnológicos

fabricación aditiva y un segundo en robótica flexible. Sin embargo, y como adelanta Oyón, en el futuro quieren unir a la red otras iniciativas vascas como son el Centro Vasco de Ciberseguridad, el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFFA) y el Centro de Fabricación Avanzada Eólico. "La idea es que,

aunque hasta ahora han existido todos esos activos y las empresas pueden dirigirse directamente a ellos, los nodos del hub posibilitarán la puesta en común de todos de esos activos, de manera que tendrán la capacidad de ofrecer a las empresas un servicio de mayor valor añadido al poder unir diferentes y tecnologías que existen en nuestro entorno". De ese modo, serán "más eficientes en recursos, uno de los aspectos que también forman parte de la estrategia de especialización inteligente, al aunar especialización y eficiencia en recursos", concluye la responsable de Iniciativas Estratégicas de la SPRI.

La puesta en servicio del Digital Innovation Hub, previsto para el mes de marzo, es una de las tres últimas iniciativas del grupo de pilotaje de Fabricación Avanzada, junto a la formación para el empleo y la búsqueda de nuevos modelos de negocio a partir de la digitalización. Todo ello abordando la fabricación avanzada en torno a cuatro grandes ámbitos: materiales y sus procesos de transformación, procesos de fabricación, medios productivos y sistemas.

Otro de los ámbitos que jugará un papel relevante en la fábrica del futuro es la eficiencia en recursos,

Cristina Oyón

Iniciativas Estratégicas en SPRI



«A los nodos de fabricación aditiva y robótica flexible se unirán otros en el futuro»

«Serán más eficientes en recursos, un aspecto que también forma parte de la RIS3»

"que aunque no siempre se incluye en la Industria 4.0, gran parte de la competitividad de nuestras empresas pasa por fabricar más eficientemente", advierte Oyón.

El objetivo final de la RIS3 vasca en fabricación avanzada es la integración de esos cuatro ámbitos y su conexión en una etapa posterior con aspectos previos y posteriores a la producción. Y "ya lo ideal sería cerrar el ciclo con todo lo relativo a la economía circular", concluye Cristina Oyón.

## ALIMENTACIÓN

### Gaiker-IK4 colaborará en el desarrollo de dos innovadores tipos de envases

A.L. Bilbao

El centro tecnológico Gaiker-IK4 colaborará con una veintena de entidades europeas en el desarrollo de dos innovadores envases para el sector de la alimentación en el marco del proyecto YPACK, enmarcado en el programa Horizon 2020.

Según explican desde el centro vizcaíno, los consumidores demandan alimentos más seguros, de mayor calidad, mínimamente procesados y fáciles de preparar y listos para comer, así como medioambientales. Esas exigencias implican el concepto de envase y activo. Y es que los

fabricantes de alimentos, transformadores y fabricantes de envases consideran el envase activo como una estrategia para mejorar la seguridad de los productos envasados y reducir los desperdicios de alimentos. Una demanda ante la que se ha lanzado YPACK con el fin de llevar a escala industrial y su posterior comercialización de dos tipos de envases de alimentos (bandejas y *flowpack*) innovadores basados en PHBV, con barreras activas y pasivas.

Para su desarrollo, obtendrán esos dos tipos de envases de alimentos

multicapa a partir de subproductos, a la vez que desarrollarán *flow pack* y bandejas termoformables biodegradables para el envasado de alimentos, envase activo a partir de extractos bioactivos y nanopartículas inorgánicas. Estas líneas de investigación se complementarán con el desarrollo de barreras pasivas basadas en celulosa nano-crystal para mejorar los dos tipos de alimentos propuestos.

En ese esquema de trabajo, Gaiker-IK4 se encargará de la laminación de los dos tipos de estructura multicapa para la formación de envases *flow pack* y bandeja termoformable y el termoformado de la estructura semi-rígida multicapa para la formación de la bandeja.

Los prototipos de los envases se realizarán de 2019 a 2020 en la compañías Linpac y Tecnopackaging.

## FORMACIÓN

### La Universidad de Deusto logra su mayor impacto en I+D

La Universidad de Deusto ha conseguido el mayor impacto de los últimos años en proyectos de I+D+i presentados a la Convocatoria de Retos y Excelencia del MINECO, con un 63 por ciento de tasa de éxito. Tras la concesión de esas ayudas, el centro docente se posiciona en su mejor marca en lo que a proyectos competitivos nacionales se refiere. La convocatoria de Retos y Excelencia, una de las más importantes en la actualidad, tiene como fin promover la generación de conocimiento.